

浙江省半导体行业协会文件

浙半发〔2026〕16号

浙江省半导体行业协会关于《车规级 AI 芯片电性参数测试方法》、《晶圆级芯片晶粒缺陷自动光学检测技术规范》 团体标准立项的通知

各有关单位：

根据《团体标准管理规定》（国标委联〔2019〕1号）、《浙江省半导体行业协会团体标准管理》有关规定，由杭州朗迅科技股份有限公司等主导起草的《车规级 AI 芯片电性参数测试方法》、由浙江机电职业技术大学等主导起草的《晶圆级芯片晶粒缺陷自动光学检测技术规范》团体标准立项建议书，经协会评估，符合立项条件，现批准立项。标准制定周期为 6 个月。

请杭州朗迅科技股份有限公司、浙江机电职业技术大学根据要求及时组建标准研制工作组，加强组织协调，抓紧落实标准研制任务，确保按时高质量完成标准制定任务。

联系人：赵燕明

联系电话：18324435116

